

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2011-06-01

广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2011 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2011 年第二次会议于 2011 年 4 月 13 日以电子邮件或书面传真方式通知全体董事，2011 年 4 月 22 日下午在公司 1 号楼二楼会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人。公司高级管理人员和部分监事列席会议，董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2011 年第一季度季度报告全文》详见 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于新增月产 10 亿只 0201MLCC 技改扩产项目的议案》

该项目规划建设期为一年，计划投资额约为 9,066 万元，其中固定资产投资为 7,316 万元，配套流动资金为 1,750 万元。该项目达产后新增销售收入约为 6,384 万元，利润约为 1,769 万元。项目投资回收期约为 4.9 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

项目具体情况详见公司将于近期披露的项目投资公告。

三、审议通过了《关于公司半导体封装测试技改扩产项目的议案》

该项目规划建设期为一年，计划投资额为 9,900.6 万元，用于扩建公司半导体封装测试生产线，其中固定资产投资为 7,900.6 万元，配套流动资金 2,000 万元。该项目达产后，新增半导体封装测试产能 11.04 亿只/年，新增销售收入约为 1.24 亿元，利润约为 2,394.8 万元。项目投资回收期约为 5.4 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

项目具体情况详见公司将于近期披露的项目投资公告。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十六日